

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年1月28日(2016.1.28)

【公開番号】特開2014-229855(P2014-229855A)

【公開日】平成26年12月8日(2014.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2014-067

【出願番号】特願2013-110634(P2013-110634)

【国際特許分類】

H 01 L 25/065 (2006.01)

H 01 L 25/07 (2006.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月7日(2015.12.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

このようにして、金属板10の上面側に、中央部に部品接続用パッドP1を備え、中央部の周囲に外部接続用パッドP2を備えた複数の配線層20を形成する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0062

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0062】

以上により、実施形態の電子部品装置1が得られる。図13に示すように、本実施形態の電子部品装置1は、下面が大気に露出した状態の配線層20を備えている。配線層20は、中央部に部品接続用パッドP1を備え、中央部の周囲に外部接続用パッドP2を備えている。部品接続用パッドP1は引き出し配線部Wを介して外部接続用パッドP2に接続されている。複数の配線層20の間の領域には永久レジスト層12が配置されている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0085

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0085】

また、図18に示す第2変形例の電子部品装置1bのように、封止樹脂50、半導体素子40及び枠部材30を削ることにより、半導体素子40の背面を露出させてもよい。これにより、電子部品装置1bの厚みを薄くすることができる。例えば、半導体素子40の厚みが50μm～30μmになるように加工される。